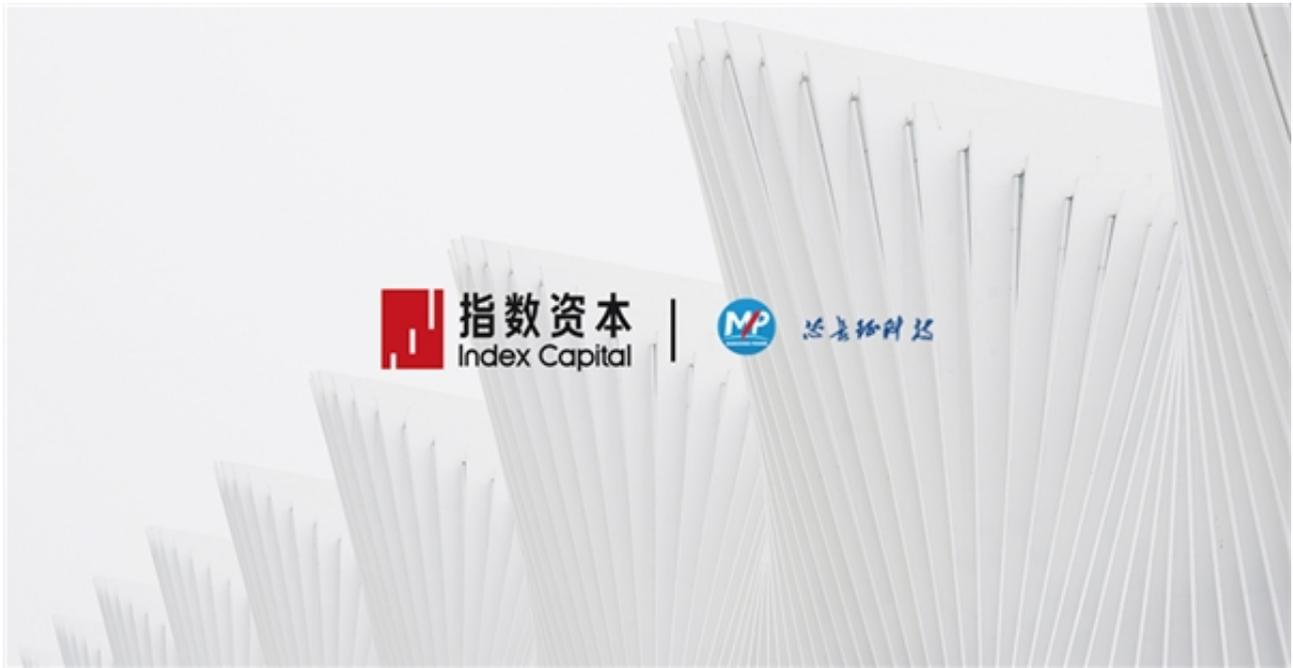


芯长征完成超5亿元C轮融资 指数资本担任独家财务顾问

近日，国际领先的新型功率半导体器件开发商芯长征宣布完成超5亿元C轮融资，本轮融资由鼎晖投资领投，北汽产业投资、高榕资本、芯动能投资、国科嘉和、一汽力合、华登国际、贵阳创投、华胥基金、新潮集团、江宁经开基金、华金资本、云晖资本、南曦资本等跟投，指数资本担任独家财务顾问。该笔资金将主要用于进一步加强新能源汽车和光伏类产品研发投入，并持续扩大产能。



芯长征 x 指数资本

芯长征董事长朱阳军表示：“在我最开始的计划中，本次融资是没有打算用FA服务的，是逸非和指数资本团队的专业认知和职业精神打动了我。随着合作的深入，指数资本的服务能力不断超出我的预期。不论是材料制作的专业度，对外精准输出公司核心价值的能力，还是交易过程中对关键问题、关键风险的敏锐嗅觉，以及应对各种问题快速形成最优落地方案的能力，指数资本的专业性体现得淋漓尽致。融资的顺利达成，指数资本起了重要的推动作用。很荣幸能和指数资本合作！”

指数资本高级副总裁王逸非表示，功率芯片是半导体领域最大的赛道之一，竞争格局相对数字芯片来说较为分散，对团队的工艺积累、市场策略、商业化能力、供应链管理等方面综合要求极高。芯长征团队在国内拥有最深厚的工艺设计能力积累，市场策略稳准狠，商业化打法高效务实，同时具备独特的供应链资源和协同生态，毫无疑问是一级市场最具价值的投资标的。我们高度看好芯长征，相信朱阳军总一定能够带领这支铁军走出属于中国功率芯的长征辉煌。

关于行业：功率半导体市场机遇巨大，国产替代尚未成熟

下游中高端应用规模快速扩大，驱动半导体功率器件市场高质量增长。随着科技发展，功率半导体器件应用领域正在从传统的工业领域快速扩展至新能源、大数据、物联网、智能电网、智能机器人、轨道交通等战略性新兴产业。

受益于下游市场需求上升，我国功率半导体市场快速扩张。其中，汽车是功率半导体下游最主要的需求，新能源是主要的市场增长动力，预计到2025年，国内汽车功率半导体市场规模将达到270亿元。除新能源汽车外，风电、光伏等应用市场容量持续扩张，带动以 MOSFET 和 IGBT 为代表的功率半导体需求持续提升，推动功率半导体通过创新融入“碳中和”战略蓝图。

此外，家电变频化趋势使得晶闸管、IGBT和MOSFET等功率半导体器件需求大幅上涨，也进一步驱动了功率半导体市场规模的高质量增长。

功率半导体面临千亿级产业机遇，高价值功率器件国产替代是最佳细分赛道。随着新基建、第三代半导体发展以及中美贸易背景下的国产替代加速等，我国功率半导体产业正迎来发展佳期。数据显示，全球功率半导体市场规模逾2600亿元，中国市场占比约为40%，而自给率不足15%，国产替代空间巨大。

受益于市场需求和国家政策的推动，目前国内部分功率器件产量不断提升。经过多年发展，我国在二极管、晶闸管等传统功率半导体产品方面大部分已实现国产化，但是整体以中低端产品为主，高端功率半导体领域在产品技术性能、多样性等方面与国际领先水平仍存在差异，如MOSFET、IGBT等高附加值产品依然较大程度上依赖进口，高端、新材料器件国产替代尚未成熟。

关于芯长征：致力于打造国际领先的功率半导体标杆品牌

芯长征科技成立于2017年，是一家专注于新型功率半导体器件设计与开发的公司，核心业务包括IGBT、Cool Mos，SiC等芯片产品及技术开发，可实现从芯片封装、测试到应用开发全链条贯通，产品覆盖消费领域、工业领域和汽车领域。从成立至今保持每年3倍以上的业务增长。

技术与产品矩阵储备完整，覆盖功率半导体高价值区间。芯长征目前是国内中高端功率器件产品覆盖最广，技术经验积累最深厚的企业之一，其产品与技术能力覆盖IGBT系列，MOSFET系列和模组系列三大条线，全面覆盖650V-1700V高附加值产业应用需求。

技术方面，芯长征掌握多项全电压段芯片设计及关键工艺技术。面向工控领域，2020年，芯长征使用更具竞争优势的第六代产品逐渐替代原来的第四代产品，其性能比国际巨头的第四代产品具有更低的损耗、更优的开关特性，同时更具性价比优势，也兼具第四代产品的高可靠高鲁棒性特点。面向新能源汽车领域，芯长征主力推出对标国际巨头同代的第七代产品，目前在和国内主流主机厂推进产品在乘用车上量产，而商用车上的产品已经全面量产。芯长征的光伏产品也已进入国内多个主流光伏逆变器厂商。

完善的上下游生态关系，获得充足的产能与订单保障。芯长征通过其自研芯片、器件的快速放量，可大幅提高议价能力，提前锁定头部产能和代工资源，并拥有完整的封测资源，实现从芯片设计-流片代工-封装-测试全链条闭环的产能保障。截至目前，芯长征已与多家国内外知名芯片代工和封测资源厂商建立了深度战略合作关系。

公司从芯片、器件向模组发展的路径优势明显，已逐步切入新能源汽车、太阳能光伏等关键场景，各类MOS、IGBT和SiC系列产品均已获得行业标杆客户认可，并批量出货。2019年下半年，公司已完成了中高端模块自有产线的建设，已具备模块自主设计及制造能力。

国内资深的功率半导体产业化团队，兼具顶尖研发能力与产品化经验。芯长征创始人兼首席执行官朱阳军博士，曾任中国科学院微电子研究所一室副主任，“IGBT”项目组和“测试及可靠性”项目组负责人、学术带头人；中国物联网研究发展中心电力电子器件研发实验室主任；中国功率器件产业与技术创新联盟副秘书长，标准委员会委员。拥有20余年半导体功率器件研究和开发经验，承担多项国家重大科技专项、中科院重点项目等重要研究任务，带领团队先后攻克全电压系列芯片关键技术，已申请发明专利158项，已发表SCI/EI收录论文20余篇。

芯长征技术团队由中科院技术专家以及行业资深技术精英共同组成，核心成员均拥有15年以上产品设计与研发、封装与测试经验，实现从芯片设计、制造工艺、封测、可靠性、应用等全链条贯通。此外，公司市场销售和运营管理团队拥有15年以上的半导体器件市场销售经验，帮助公司实现从产品设计开发到量产市场化的完整闭环。

原文地址：<http://www.china-nengyuan.com/news/176612.html>